

# 华润微电子有限公司

## 投资者关系活动记录表

(2026 年 2 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别 | <div><input type="checkbox"/>特定对象调研    <input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访            <input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会        <input checked="" type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div>                                                                                                                                                  |
| 参与单位名称    | <div>02 月 02 日</div> <div>瑞银证券、华泰证券、信达澳亚基金、China Pinnacle Equity Management、Sumitomo Mitsui DS Asset Management 、Hua An Fund Management、Sharewin Equity Fund Management、Franchise Capital、Fidelity International、Value Partners Group Limited</div> <div>02 月 03 日</div> <div>中泰证券、中邮基金、中银基金、永赢基金、平安基金</div> <div>02 月 04 日</div> <div>华福证券、中欧基金、东吴基金、中银资管、弘震资产、利多星投资、积序资本、华福自营、上海厚港基金、财通基金、上海复星投资、华泰资产</div> <div>02 月 12 日</div> <div>摩根大通证券、长江证券、中信建投证券、华夏基金、平安人寿、圆信永丰基金、南土资产、泰康资产、盘京投资、聚鸣资产、天弘基金</div> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 时间            | 02 月 02 日、02 月 03 日、02 月 04 日、02 月 12 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 地点            | 上海、无锡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 上市公司接待人员姓名    | 吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘<br>沈筛英 华润微电子董事会办公室主任                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>问题一：公司已于 2 月份正式发布涨价函，请问除了成本上涨外，还有哪些因素驱动产品涨价？</b></p> <p>答：公司 2 月发布价格调整函，自 2026 年 2 月 1 日起对产品业务提价，幅度 10%起。本次价格调整主要基于两方面因素：一是上游原材料及关键贵金属价格持续攀升，导致晶圆制造成本与封测成本上升；二是下游需求呈现结构性增长，汽车电子、储能、工业控制、AI 服务器等领域景气度高，公司产能持续满载。国内外同行近期亦相继涨价，表明功率半导体经历调整后已步入回升阶段。</p> <p><b>问题二：请问公司未来业务增长点有哪些？</b></p> <p>答：公司全面布局三条业务增长曲线：第一曲线是硅基功率半导体，依托重庆、深圳 12 吋产线，融合功率器件与 IC，提升模块化及系统级方案能力，夯实基本盘；第二曲线是第三代半导体，加速 SiC、GaN 在车规、数据中心、光伏储能等高景气赛道的产业化进程，目标实现每年营收保持高速增长。第三曲线是高端传感器及光芯片，以具体应用场景为驱动，与终端客户联合开发，强化产能与制造优势。三大曲线形成“算能-传输-感知”全链条生态，同时计划通过投资并购补强产品线，提升综合竞争力及市占率。</p> <p><b>问题三：请问公司在股权投资方面的整体策略？重点在哪些领域寻求投资或并购机会？对潜在标的的筛选标准有哪些核心考量？</b></p> <p>答：公司聚焦主业，围绕功率半导体、智能传感器、智能控制领</p> |

域积极寻找优质项目。筛选标准主要考虑两点：一是在产品、技术、终端应用等方面与公司现有业务形成互补协同；二是标的具备一定规模体量，能够对公司战略布局形成实质性贡献。

**问题四：当前 AI 算力需求爆发，公司如何看待其对功率半导体带来的结构性机遇？在 AI 服务器电源、数据中心等核心基础设施领域，公司的产品布局和客户进展如何？**

答：AI 算力需求激增，数据中心功耗大幅提升，单台服务器功率器件价值量较传统服务器增长近 5 倍，驱动功率开关、电源管理芯片需求旺盛。公司 SGT MOS、超结 MOS、SiC MOS 等功率器件及电源模块，已批量供货给海内外一些头部厂商；GaN 产品进入客户测试阶段。相关业务未来增长空间广阔。

**问题五：汽车电子对公司整体营收的贡献比例如何？请问公司 2026 年对汽车电子的展望？**

答：目前汽车电子在公司产品与方案板块的收入占比约为 20%，且呈现逐年增长态势。公司近百款车规级功率器件、IC 及模块产品快速上量，覆盖电驱、电源、电控到车身域全场景，同时主驱模块已实现批量供货。在智能驾驶领域，公司开发高可靠性车规级芯片与系统方案，支持自动驾驶感知、决策与执行全环节。未来将继续扩大车规产品线，深化与核心车企及 Tier 1 合作。

**问题六：请问公司在碳化硅产品的布局及技术亮点？**

答：公司最新 SiC MOS G4 产品已开发 650V/1200V 平台数十颗产品，通过 AEC-Q101 认证并实现量产。相较于上一代，G4 产品功率密度和转换效率显著提升，适用于 OBC、AI 服务器电源等高功率密度场景。模块方面，基于 G4 芯片的 HPD/DCM/VD3 等封装形式的主驱模块已系列化，系统损耗进一步降低，部分实现批量上车。

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>技术布局上，公司实现 650V-2200V 全电压段覆盖，8 吋 SiC MOS 产品系列持续丰富。目前在新能源汽车、充电桩、光伏、数据中心等领域标杆客户均已稳定批量出货。</p> <p><b>问题七：请问公司在氮化镓产品的布局及技术亮点？</b></p> <p>答：公司氮化镓产品采用双轨技术路线：650V 及以上高压领域采用 D-mode 技术路线并依托 6 吋产线规模量产，G4 平台大功率工控类产品已通过客户验证，并已启动下一代 G5 平台研发。40V-650V 领域采用 E-mode 技术路线并依托 8 吋产线生产，目前已有头部企业合作项目。产能建设方面，外延中心正式投用，产能稳步提升，8 吋 E-mode 外延能力也已打通。GaN 产品具有高效率、低能耗、高频率、小体积等优势，可广泛应用于手机快充、数据中心电源、5G 通信电源、伺服电机、车载系统、AI 供电、机器人、激光雷达等领域。</p> <p><b>问题八：公司在人工智能领域有哪些布局和进展？</b></p> <p>答：公司实现端侧与云端协同发展。在端侧 AI 领域，产品覆盖 AI 手机、AI PC、汽车智能化、工业自动化、人形机器人等场景，推出适配多电机控制与机器人关节的高性能 MCU 与 IPM 模块；传感器重点布局光学传感器，并拓展压力、硅麦克风、惯性传感器，满足 AI 数据感知需求。在云端 AI 领域，除持续为服务器批量供应功率器件外，积极推进 SiC、GaN 产品在数据中心电源中的应用验证，助力公司在高潜力赛道建立领先优势。</p> |
| 附件清单（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 日期       | 2026 年 2 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |